

<<半导体光电器件封装工艺>>

图书基本信息

书名：<<半导体光电器件封装工艺>>

13位ISBN编号：9787121128875

10位ISBN编号：712112887X

出版时间：2011-6

出版时间：电子工业

作者：陈振源

页数：95

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<半导体光电器件封装工艺>>

内容概要

本书(陈振源任总主编)针对整个半导体光电器件封装所用条件及工艺流程进行介绍,包括:光电器件封装规范、扩晶工艺、装架工艺、引线焊接工艺、器件封装工艺、产品的检测与包装6个项目,对半导体光电器件封装工艺流程及技术要求都做了说明,内容浅显易懂,注重实际操作工艺及理论联系实际的能力。

本书适合中等职业学校光电相关专业的学生使用,也可以作为光电器件封装技术工人的培训教材。

为了方便教师教学,本书还配有部分技能训练实际操作的教学光盘,供教学使用。

<<半导体光电器件封装工艺>>

书籍目录

项目一 光电器件封装规范

任务一 了解光电器件的封装工艺环境

一、光电器件的封装

二、光电器件封装工艺环境

复习思考

任务二 光电器件封装安全性的认识

任务三 光电器件封装过程中的安全防护

一、封装安全防护之防静电规程

技能训练一 静电防护装备及设备识别与配备（见光盘）

二、封装安全防护之操作人员规程

复习思考

项目小结

项目二 扩晶工艺

任务一 识别芯片信息

一、芯片的信息

二、芯片的存储

复习思考题

任务二 扩晶工艺

一、扩晶的目的

二、扩晶设备

三、扩晶工艺过程

四、扩晶技术要求及注意事项

技能训练二 扩晶工艺实操（见光盘）

复习思考题

任务三 芯片的镜检

一、芯片的分选技术

二、芯片的镜检

.....

项目三 装架工艺

项目四 引线焊接工艺

项目五 器件封装工艺

项目六 产品的检测与包装

附录A 5S企业管理规范

附录B 光电行业常用长度单位的换算

附录C 本书配套最简单实训室配置

参考文献

<<半导体光电器件封装工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>